

結晶主面方位・カット面の測定・検査受託を行います。

# Si、SiC、GaAs、GaN、InP、 サファイア、水晶、ダイヤモンドなどの 単結晶材料の結晶方位測定

ウエハー Φ300mm 測定にも対応

Φ50mm Φ100mm Φ150mm Φ200mm のそれぞれの測定が可能です。

- ▶ **自社に設置場所が無い。  
使用頻度が低いので、装置の購入費用負担が重い。**

受託測定で、装置の使用時間料の経費で済ませます。

- ▶ **自社に専用の検査装置はあるが、イレギュラーな測定に使用出来ない。  
治具の変更や設定が面倒。**

結晶報告測定に従事する技術者が測定装置を選定して、最適な方位測定を実施します。

- ▶ **結晶方位測定に通じた技術者が装置を選定して、  
ご目的の方位測定を行います。**

測定料金は、測定内容毎に御見積致します。

結晶主面方位・カット面の測定・検査受託を行います。

### 1 結晶カット面検査機 SCO-a

結晶の測定方位面 (hkl) が分かっている試料について 予め X 線入射角・回折線角 ( $2\theta$ ) を設定します。想定する偏差角を探る測定角度範囲 ( $\omega$  最大  $\pm 10^\circ$ ) を走査してロックングカーブ計測を行います。観測回折線の半価幅中点法で、偏差角を求めます。

### 2 X 線結晶方位自動測定装置 SCO-Multi

結晶の主面方位の測定を行うシステムです。

結晶面 (hkl) に対する X 線回折角 ( $2\theta$ ) と測定角度範囲 ( $\omega$ ) を設定、試料回転  $0^\circ \cdot 180^\circ$  又は  $0^\circ \cdot 90^\circ \cdot 180^\circ \cdot 270^\circ$  を行い 各回転位置ごとに ( $\omega$ ) 角走査を行います。一連の測定値から格子面方位角の算出・表示を行います。測定角度再現精度は  $\pm 0.01^\circ$  程度です。

### 3 Si ウエハ判別機 SCO-c

Si ウエハ 1.0.0 (ノッチ、オリフラ) 方位か? 1.1.0 の面方位か? 判別検査します。結果をパネル画面標示。測定時間 1 秒にこだわった判定機です。

ウエハー径  $\phi 300 \phi 200$  対応

大量のウエハーの判別検査に対応して、  
一定期間、装置の一時貸し出し運用もご相談いただけます。